

行业及产业

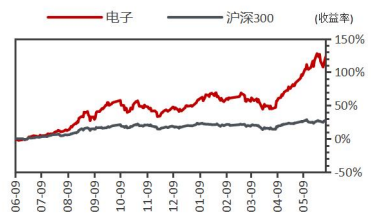
电子

端侧 AI PC 产业化落地，云端算力需求持续爆发

——电子行业周报（2026/6/1-6/7）

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

《电子行业周报：长鑫科技 IPO 迎来关键节点，Intel 加码玻璃基板与硅光子》2026-06-01

《电子行业专题报告：华为发布 τ 定律，助力后摩尔时代半导体产业发展》2026-05-28

《电子行业周报：AI 算力高景气延续国产存储替代加速》2026-05-25

《电子行业跟踪报告：电子布行业具备估值提升潜力》2026-05-25

《电子行业专题报告：AI Glasses 开启智能穿戴时代》2026-05-15

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

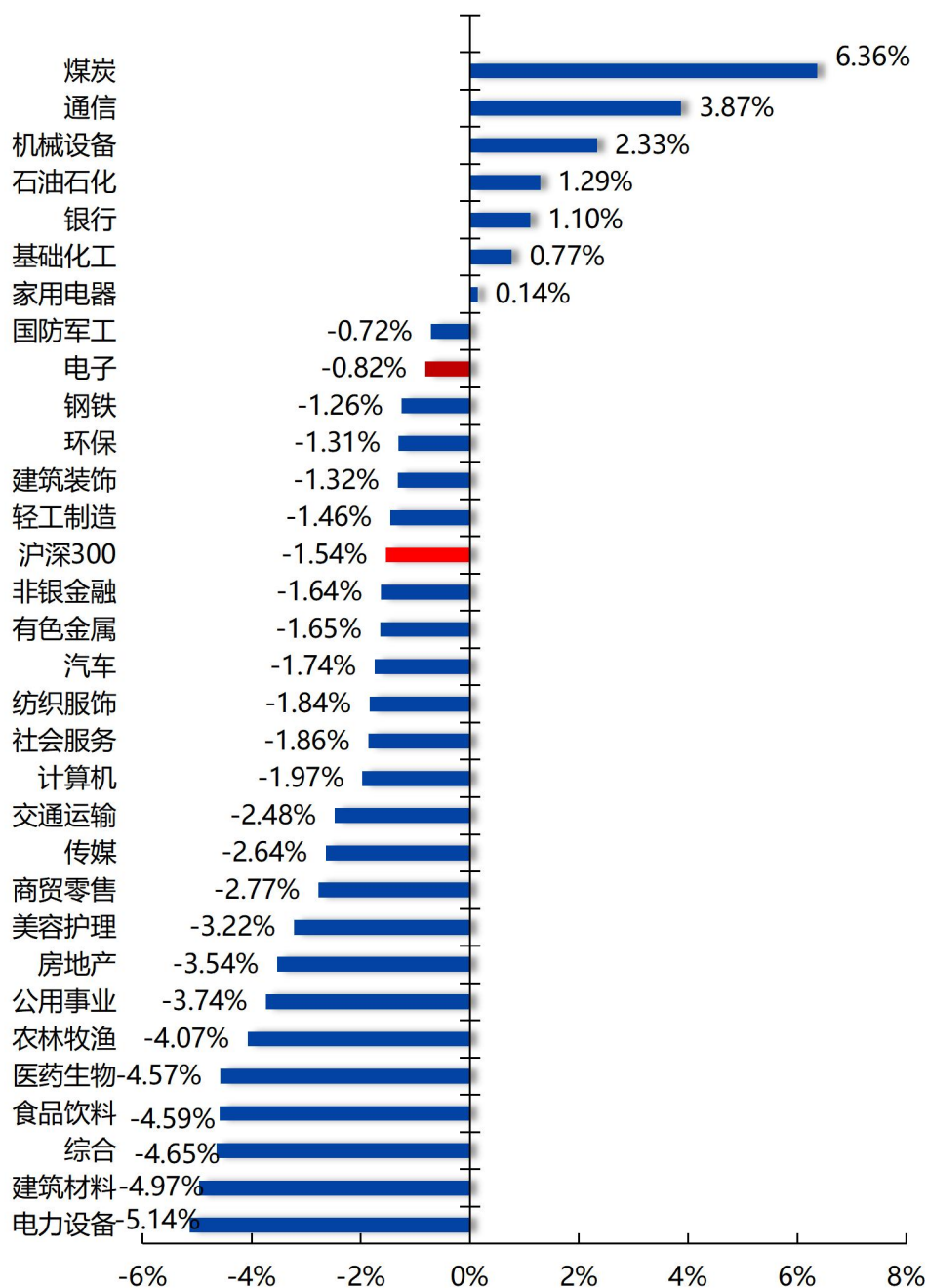
- 本周（2026/6/1-6/7）SW 电子行业指数（-0.82%），涨跌幅排名 9/31 位，沪深 300 指数（-1.54%）。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭（+6.36%），通信（+3.87%），机械设备（+2.33%），石油石化（+1.29%），银行（+1.10%），涨跌幅后五分别为：电力设备（-5.14%），建筑材料（-4.97%），综合（-4.65%），食品饮料（-4.59%），医药生物（-4.57%）。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：面板（+15.60%），被动元件（+9.68%），半导体材料（+5.53%），涨跌幅后三分别是：集成电路制造（-7.64%），模拟芯片设计（-5.07%），集成电路封测（-3.96%）。
- 本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：麦捷科技（+52.71%）、美迪凯（+51.04%）、钧崴电子（+40.28%）、华特气体（+37.46%）、中船特气（+32.32%）。涨跌幅排名后五的股票分别是：利通电子（-25.07%）、朗特智能（-19.58%）、东田微（-16.84%）、光智科技（-15.44%）、强达电路（-15.31%）。
- 2026 年 6 月 1 日，NVIDIA CEO 黄仁勋在 GTC Taipei 2026 大会上正式宣布全面进军个人电脑通用计算芯片市场，并发布 Vera Rubin 平台全面量产、新一代 DRIVE Hyperion 自动驾驶出租车平台等多项重磅产品与技术。本次推出的 RTX Spark 芯片采用 TSMC 3nm 先进制程，集成 NVIDIA Blackwell 架构 GPU 与联发科联合定制的 Arm 架构 N1X CPU，标配 128GB 统一内存，可实现 CPU 与 GPU 算力高效协同。该处理器由 NVIDIA、联发科联合研发，微软提供系统适配支持，将率先搭载于 Microsoft、DELL 等品牌的新一代 Windows 笔记本与台式机，预计 2026H2 正式上市。
- 美国时间 2026 年 6 月 3 日，Broadcom 发布 2026Q2 财报。财报显示，公司当期总营收达 221.87 亿美元，同比+48%，创下公司近年单季营收同比增速新高。营收结构方面，公司业务分为半导体解决方案与基础设施软件两大板块，当期分别实现营收 150.1 亿美元和 71.77 亿美元。细分业务来看，半导体板块的高增长完全由 AI 相关产品驱动，核心增量来自 AI 定制加速芯片与 AI 网络芯片。2026Q2 Broadcom AI 相关半导体产品营收达 108 亿美元，同比+143%，定制 ASIC 与算力网络芯片为核心出货品类。业绩指引方面，Broadcom 预计 2026Q3 集团整体营收约 294 亿美元；其中市场高度关注的 AI 半导体业务，公司给出 160 亿美元的营收指引，对应同比增幅超 200%，产品将继续聚焦云端算力及大型数据中心定制化芯片市场。
- 投资建议：NVIDIA 于 GTC 台北发布会推出的 RTX Spark 超级芯片，产品采用 TSMC 3nm 制程、CPU+GPU 异构融合架构，预计 2026H2 搭载于 Microsoft、DELL 终端机型批量上市，正式打开 AI PC 硬件规模化放量空间；Broadcom 发布 2026Q2 财报，当期 AI 半导体营收 108 亿美元，同比+143%，同时上调 Q3 AI 业务营收指引至 160 亿美元，同比增幅突破 200%，强力印证全球云端算力资本开支高景气。建议关注 AI 算力+AI PC 产业链相关上市公司投资机会。
- 风险提示：1) 下游需求不及预期风险；2) 行业供给过剩与产品降价风险；3) 技术迭代与地缘贸易风险。

1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数 (-0.82%)，涨跌幅排名 9/31 位，沪深 300 指数 (-1.54%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭 (+6.36%)，通信 (+3.87%)，机械设备 (+2.33%)，石油石化 (+1.29%)，银行 (+1.10%)，涨跌幅后五分别为：电力设备 (-5.14%)，建筑材料 (-4.97%)，综合 (-4.65%)，食品饮料 (-4.59%)，医药生物 (-4.57%)。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

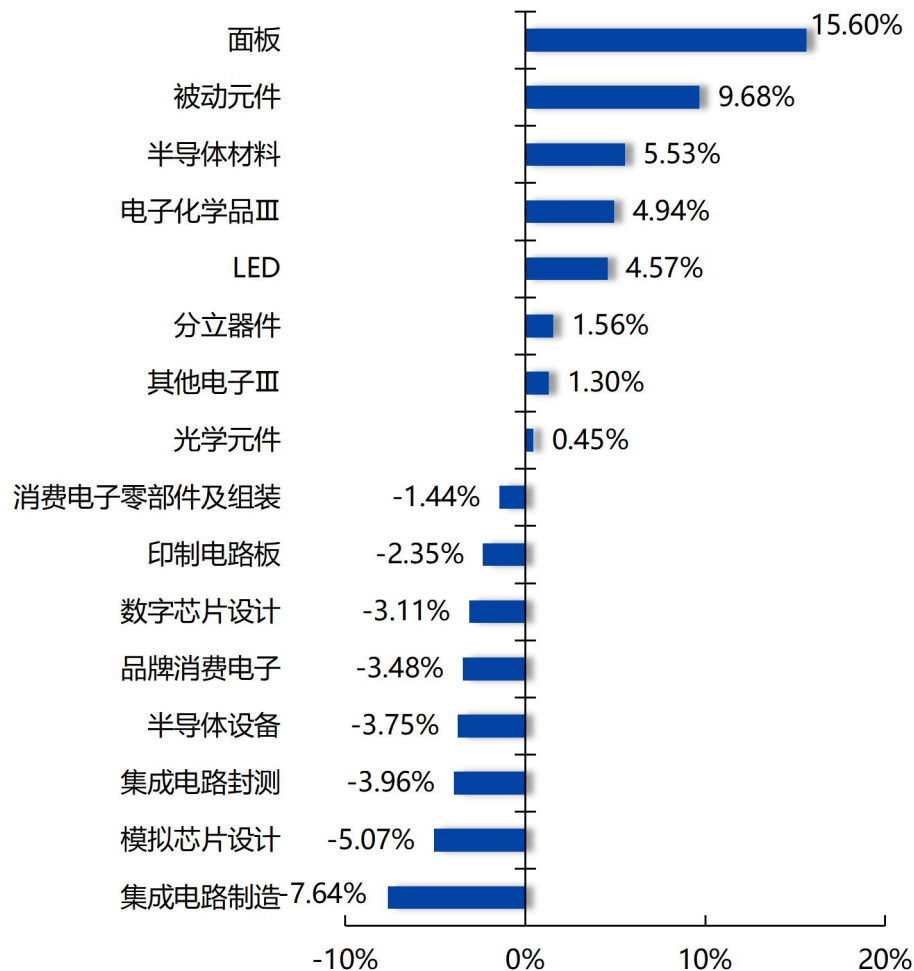


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：面板(+15.60%)，被动元件(+9.68%)，半导体材料(+5.53%)，涨跌幅后三分别是：集成电路制造(-7.64%)，模拟芯片设计(-5.07%)，集成电路封测(-3.96%)。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览

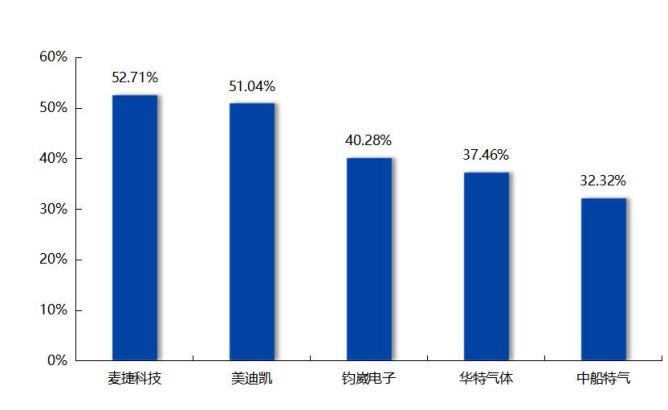


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

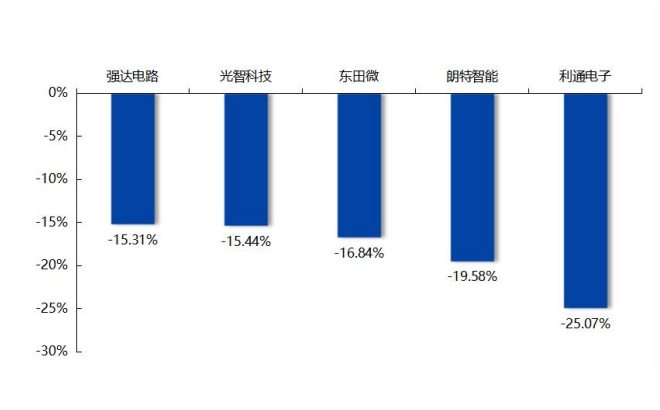
本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：麦捷科技(+52.71%)、美迪凯(+51.04%)、钧崴电子(+40.28%)、华特气体(+37.46%)、中船特气(+32.32%)。涨跌幅排名后五的股票分别是：利通电子(-25.07%)、朗特智能(-19.58%)、东田微(-16.84%)、光智科技(-15.44%)、强达电路(-15.31%)。

图表 3：SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

图表 4：SW 电子个股本周涨跌幅后五

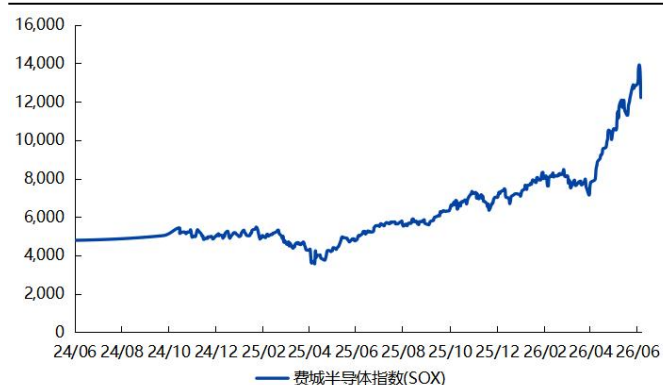


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为-4.74%，恒生科技指数本周涨跌幅为+0.09%。

图表 5：本周费城半导体指数涨跌幅为-4.74%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

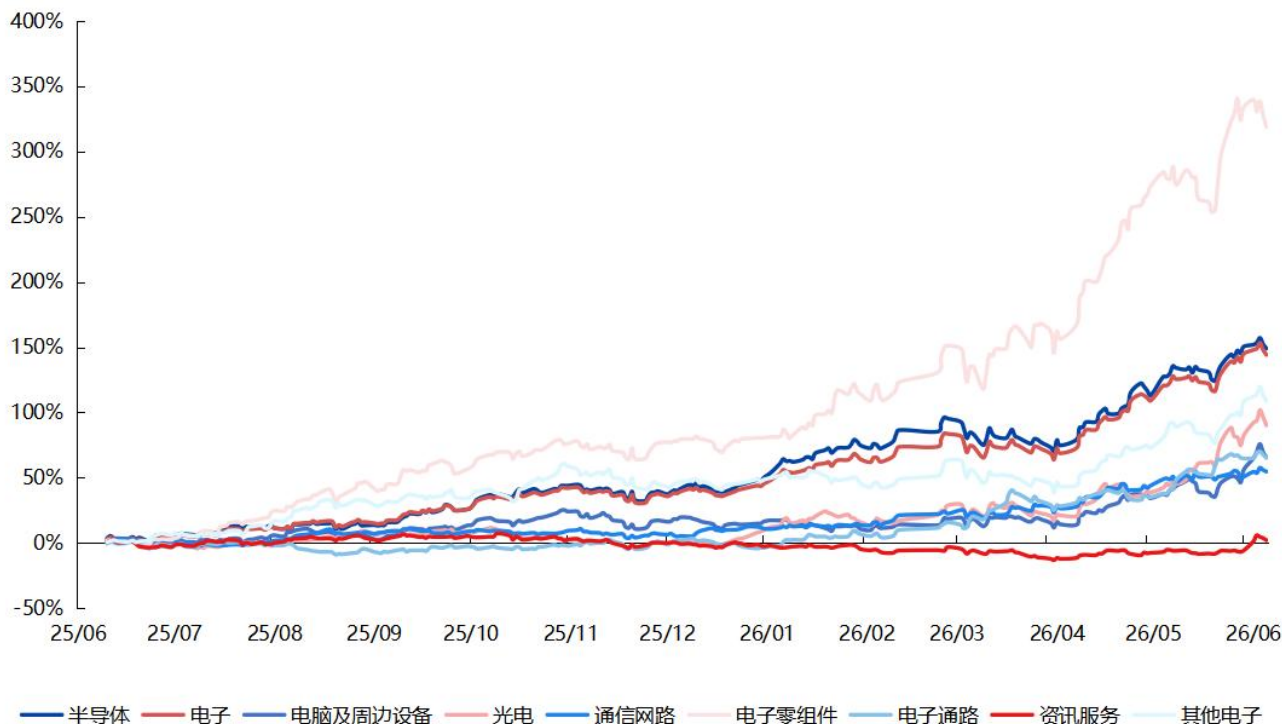
图表 6：本周恒生科技指数涨跌幅为+0.09%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

中国台湾电子指数各细分板块本周涨跌幅分别为：半导体 (-0.59%)、电子 (-0.37%)、电脑及周边设备 (+6.03%)、光电 (+4.17%)、通信网路 (+2.58%)、电子零组件 (-3.54%)、电子通路 (+0.36%)、资讯服务 (+8.26%)、其他电子 (+0.12%)。

图表 7：2025 年 6 月-2026 年 6 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 NVIDIA 发布 RTX Spark 超级芯片

2026 年 6 月 1 日，NVIDIA CEO 黄仁勋在 GTC Taipei 2026 大会上正式宣布，公司将全面进军个人电脑通用计算芯片市场，并宣布 Vera Rubin 全面量产、DRIVE Hyperion 新一代自动驾驶出租车平台等多项重磅技术与产品。

本次推出的 RTX Spark 芯片采用 TSMC 3nm 先进制程，集成 NVIDIA Blackwell 架构 GPU 与联发科联合定制的 Arm 架构 N1X CPU，标配 128GB 统一内存，可实现 CPU 与 GPU 算力高效协同。

这款由 NVIDIA 与 Microsoft 联合打造的全新处理器，将率先搭载于 Microsoft、DELL、等品牌的新一代 Windows 笔记本及台式机产品中，预计将于 2026H2 正式上市。

2.2 Broadcom 披露 2026Q2 财报

美国时间 2026 年 6 月 3 日，Broadcom 发布 2026Q2 财报。财报显示，公司当期总营收达 221.87 亿美元，同比+48%，创下公司近年单季营收同比增速新高。营收结构方面，公司业务分为半导体解决方案与基础设施软件两大板块，当期分别实现营收 150.1 亿美元和 71.77 亿美元。

细分业务来看，半导体板块的高增长完全由 AI 相关产品驱动，核心增量来自 AI 定制

加速芯片与 AI 网络芯片。2026Q2 Broadcom AI 相关半导体产品营收达 108 亿美元，同比+143%，定制 ASIC 与算力网络芯片为核心出货品类。

业绩指引方面，Broadcom 预计 2026Q3 集团整体营收约 294 亿美元；其中市场高度关注的 AI 半导体业务，公司给出 160 亿美元的营收指引，对应同比增幅超 200%，产品将继续聚焦云端算力及大型数据中心定制化芯片市场。

2.3 联发科敲定 EMIB-T 封装方案

2026 年 6 月 2 日，联发科官宣下一代定制芯片项目敲定封装方案，产品将独家采用 Intel EMIB-T 进封装工艺；项目关键日程落地，芯片流片 (tape-out) 锁定 2026Q4，规模化量产规划于 2027Q4。

该 EMIB-T 定制芯片为面向云端的 AI ASIC 及数据中心处理器，是联发科企业级算力芯片核心落地项目。

EMIB-T 为英特尔迭代优化的嵌入式硅桥先进封装技术，不同于 TSMC CoWoS 整片硅中介层互联架构，依托局部嵌入式微型硅网桥实现多裸片互连，适配大尺寸芯片集成与 HBM 高速内存互联需求，是 Intel 对标 CoWoS 的核心竞争工艺，公司自 2025 年持续推进良率提升与产能扩充。

2.4 欧盟推出《芯片法案 2.0》

2026 年 6 月 3 日，欧盟正式发布“欧洲技术主权方案”，整体由两项立法文件及两份产业战略组成，重点覆盖半导体、人工智能、云计算、算电协同四大领域，市场此前预期的《芯片法案 2.0》正式纳入政策框架。

《芯片法案 2.0》为初代芯片法案升级版本，在原有扶持本土产能基础上，重点强化先进制程、Chiplet 异构集成、3D 先进封装等前沿技术扶持。法案明确将筹建欧洲首座集先进晶圆制造、芯粒集成、3D 先进封装于一体的综合性半导体工厂，预计 2030-2033 年试生产，并纳入欧盟 IPCEI 重点项目候选清单。

政策进一步优化半导体产业投融资与补贴审批流程，欧盟可直接参与跨国半导体项目投资，并联动汽车、工控、云计算等下游产业拉动本土芯片采购需求，保障新建产线稼动率。

3. 风险提示

1) 下游需求不及预期风险：全球消费电子景气疲软，AI PC 终端消费者换机意愿偏弱，叠加云厂商缩减资本开支，导致 AI 芯片、服务器、光模块等上游零部件订单放量低于行业预期。

2) 行业供给过剩与产品降价风险：海内外芯片厂商加速扩产算力芯片、存储及 PCB 产能，行业供给快速抬升引发产品价格下行，压缩产业链企业毛利率水平。

3) 技术迭代与地缘贸易风险：新一代芯片架构技术迭代节奏超预期，现有产品面临技术淘汰；国际贸易政策变动、出口管制加剧，扰动海外大厂供应链合作与元器件进出口节奏。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。